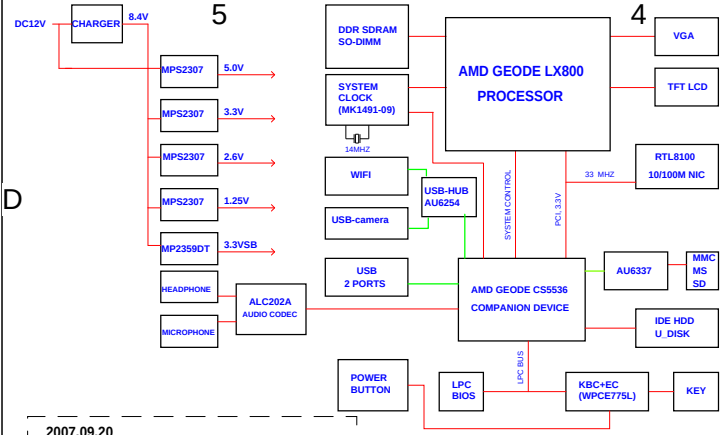


2007.12.06
page12 : 增加R545=10K
page 9 : change U15封装为 SSOP28;
VR11改为 NC; L15改为 1210-100R磁珠;
R297=NC;R295=0R;C59=105;C72=105;R115=NC;

2007.12.19
page10 :增加3.3V和5.0V放电电路;
电感 L6 L7 L8 L9型号更改为 RP06X031M10U;
电感L15滤单改为电阻 1210-100R;
page11:R330更改为 47K;
page7: 增加内置 MIC电路，增加 J11，C103=101;
R9 改为 1K;

2007.12.27
1、把摄像头、内置 MIC、电源开关统一为一个插座;
2、增加风扇插座

2008.01.03
page16 :增加TC6=10PF,
解决其创 Linux操作系统关机白屏问题;
page10: 增加FB62=100R,L15不贴;

2008.01.04
DDR排阻调换 PIN脚顺序，方便布板;
1、RN8.6与RN8.7互换
2、RN25.4与RN25.2互换
3、RN23.1与RN23.2互换
4、RN23.3与RN23.4互换
5、RN22.4换到RN22.1
RN22.1换到RN22.3
RN22.3换到RN22.2
RN22.2换到RN22.4
6、RN20.4与RN20.1互换
7、RN20.3与RN20.2互换
8、RN18.2换到RN18.1 RN18.1与RN18.4互换
9、RN14.1换到RN14.3 RN14.3换到RN14.2
RN14.2换到RN14.1
10、RN11.1与RN11.2互换
11、RN10.3与RN10.4互换
12、RN9.1与RN9.2互换
13、RN7.1与RN7.4互换
14、RN3.4换到RN3.1 RN3.1换到RN3.2
RN3.2换到RN3.3 RN3.3换到RN3.4
RN2.1与RN2.4互换
15、RN2.2与RN2.3互换
16、RN1.2换到RN1.1 RN1.1换到RN1.3

2008.01.05
增加4个封装名为 hole237cir100d 的孔,
7个封装名为 hole237cir100d_a1 的孔

2008.01.11
C363 FB35删除;
VR18 VR20 VR21 VR22改为接GND;

2008.01.15
J6放在BOT层，为保持充电保护板插座一致，
封装改为 PC-BATCON7-T2.5-DIP-R

2008.01.16
键盘插座CN13更改顺序;
CN2改变顺序;

2008.03.10
page11:增加C401,22uF/10V;解决操作系统关机白屏
增加R349,47R;
page16:J15更改为 PIN16,把MIC信号放进去;
摄像头,USB口，USB+和USB-位置互换;
page06：2个USB改为由 南桥控制;
wi-fi 和摄像头由 usb-hub输出;

2008.03.13
page11:增加D51,IN5819;
MQ30,2N7002;
R232=100K;
R68=NC,
R69=10K

2008.03.14
page6:增加FB30=100,
R605=NC

2008.03.15
page17 : 增加MR15=MR16=330R;
page16: 增加风扇 V5.0_FAN控制电路,
R214=R193=10K,
Q14=2N3904,
R188=100K,TC15=224,
Q22=IRLML6401
FB31=100,

2008.03.18
page16: LVDS插座更换封装
J19 更换为 CON20_1.0MM_HC
J15 更换为 CON6_1.0MM_HC
page11: 增加F5=F1206HI-2000V063T SMD
充电保险丝
page16: FB11=FB20改为 0805封装

2008.04.23
PAGE 16:
更改内容:(绿色位号部份)
1.增加了TRN9,TRN12,TRN13,R240,R241,R242,R243,R319,
R320,FB38
2.FB36,FB37,J21,CN20
兼容实现:
1.J19与J21不会同时贴,可让引脚错开放置在一起。
2.现有8" 新增的器件不贴,其余不变,包括LVDS连接线
3.CPT 8.9" 新增器件1贴上,以下器件不贴TRN8,TRN10,
TRN11,TR54,TR55,TR56,TR57,TR58,TR59,R308,R309,R148,
R149,R236,R237。同时更改连接线的定义
4. 联创7"
新增器件1,2贴上,但FB38不贴。不贴的器件在CPT8.9"的基础上
不贴:U9,R283,R284,R282,R285,TC13,TC12,TCA6,TC7,TCA8,TC9,
R340,R339,R335,R337,R345,R346,R341,R342,R343,R344,TC6
需要有转接板将连接线转成FPC连接线.在转接板上
将屏要求的MODE拉到3.3V,有扫描方向的设置
page16:FB31更改为 0805封装

2008.04.26
page2: 增加R40=10.0K%1,
R6 改为NC
page16：D51=NC,R56=10K;
page6: 增加L27

2008.05.06 增加 EMI对策
page3: 增加FB71 0402磁珠;
page4: 增加1.8寸键盘 电路;
page5: 增加FB72 磁珠0603-100;
删除C67,FB1;
增加FB21,FB35 磁珠0603;
增加FB72 磁珠0603;
增加R244 0402-NC;
page6: 删除C362,FB34;
更改FB9,FB10 磁珠600;
更改FB29为 磁珠0805-100;
page7: 删除R601,FB63,FB64,FB65,FB67,FB5,C326;
page8:删除C361,FB33
page17 :删除C87,FB21;
page11:删除C363,FB35;
增加FB73,FB74 磁珠0603
增加FB5,FB33 磁珠1206

2008.05.10
page17:增加VIA12 VIA13耳机屏蔽罩固定孔;
page16:增加C613 C614 C615 贴片电容0603-104;
page11:增加C87 贴片电容1210-22uf/16V;

2007.09.20
page17: add Hall Switch;
page11: J6 change footprinit BATCON9_T2.5_DIP;
page2 : 所有排阻镜像，方便布板;
page17: add 8个螺丝孔;

2007.09.21
page11: change CN8 封装CON2_2.54MM_DIP_B;
page17: change J5 pin1 net PWRK_KEY;
page17 : change 螺丝孔接地网络 CHASSIS;
page7 : change CN6 封装CON6_1.0MM_RX;
page12: change J7 封装 FPC-26-SMT-LI;
page4 : J14 add pin45 pin46 到GND

2007.09.22
page4 : J14 add pin45 pin46 到GND
page12 : U24 pin117、pin64 脚网络对调

2007.09.24
page12 : add R543=10K;
page12 : U24 pin114 add TP13 测试点;
page13 : U24 pin84 add TP12 测试点;
page12 : RN38 上下镜像，方便走线;
page11 : VR11 改接GND;

2007.09.25 将机械地分开，方便布板
page6 : add C362, FB34 ;
page11: add C363, FB35 ;

2007.09.27
page17 : add 6个MARK点;
page3 : SMB_SDA_1与SMB_SCL_1短路
将其分开;

2007.09.28
page7 : VR18 VR20 VR21 接GND_audio;
page9 : R40 接GND;
page7 : add R559 R566 R578 R579 =10K;
page12: add TP14 TP15 TP16测试点;
page13: add R580 R581 R582 =22;

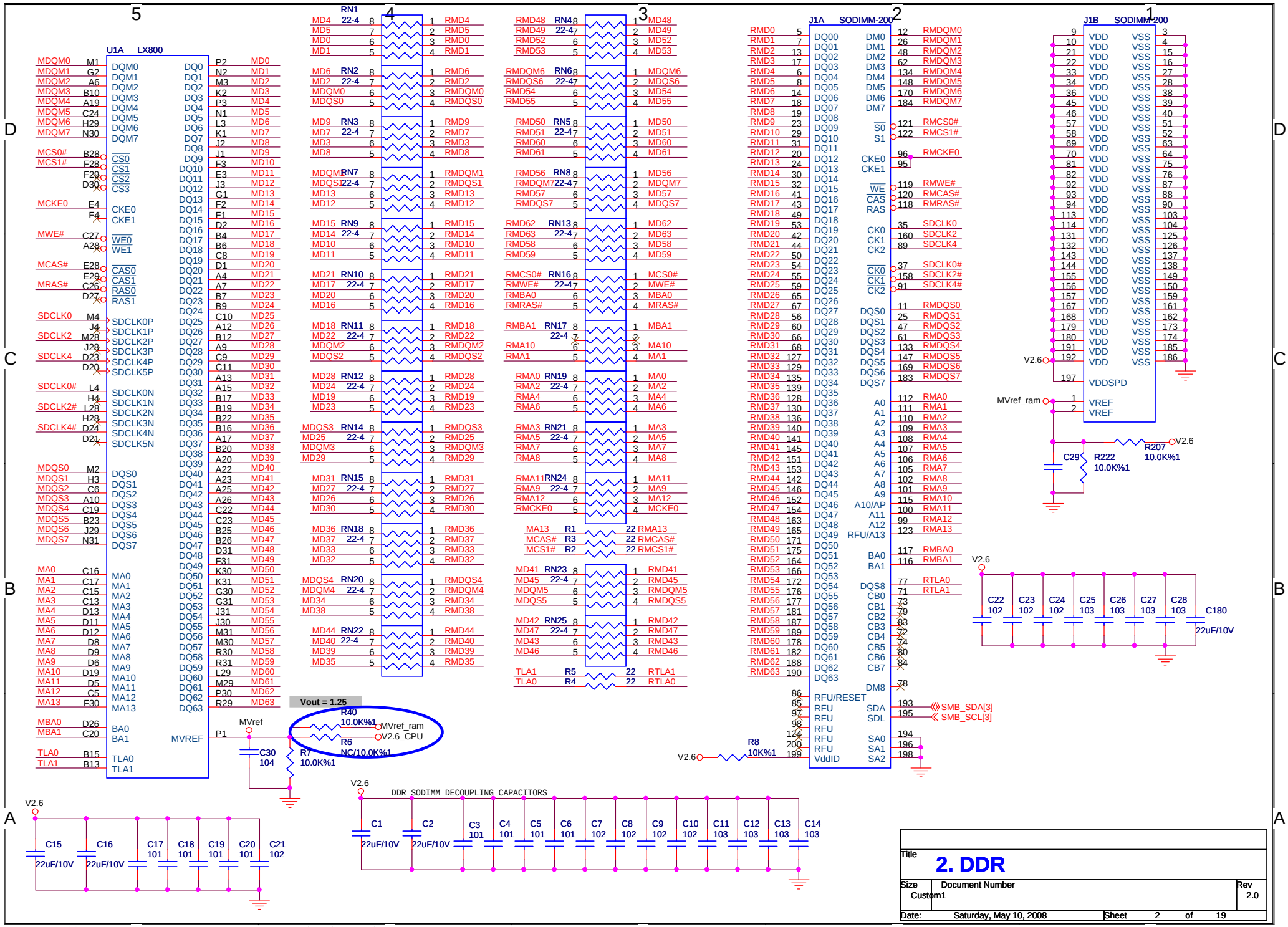
2007.09.29
page10 : add C302=104 ;
C73 移到L15的后端;
page9 : BAT1 PIN1与PIN2互换;

2007.11.16
page11: C278,C105删除，增加 CA116,B-22uF/16V;
C280 更改为 100PF;
R197 更改为 1K;
R326 更改为 150K,R329更改为 51K;
R290 更改为 10M,R291更改为 4.7M;
C273,C87 删除,增加CA117,D-100uF/16V;
删除Q27,R244,R274,R243,R589,Q36;
R200 由10K改为 1K;
增加电感L18,0603-10uH,C452,0402-104;
page12: 增加R544,NC/10K;
R570 改为NC;
page16: 增加R323,NC/0;
R311 改为对地电阻， 47K;
page17: 增加R116,NC/1K

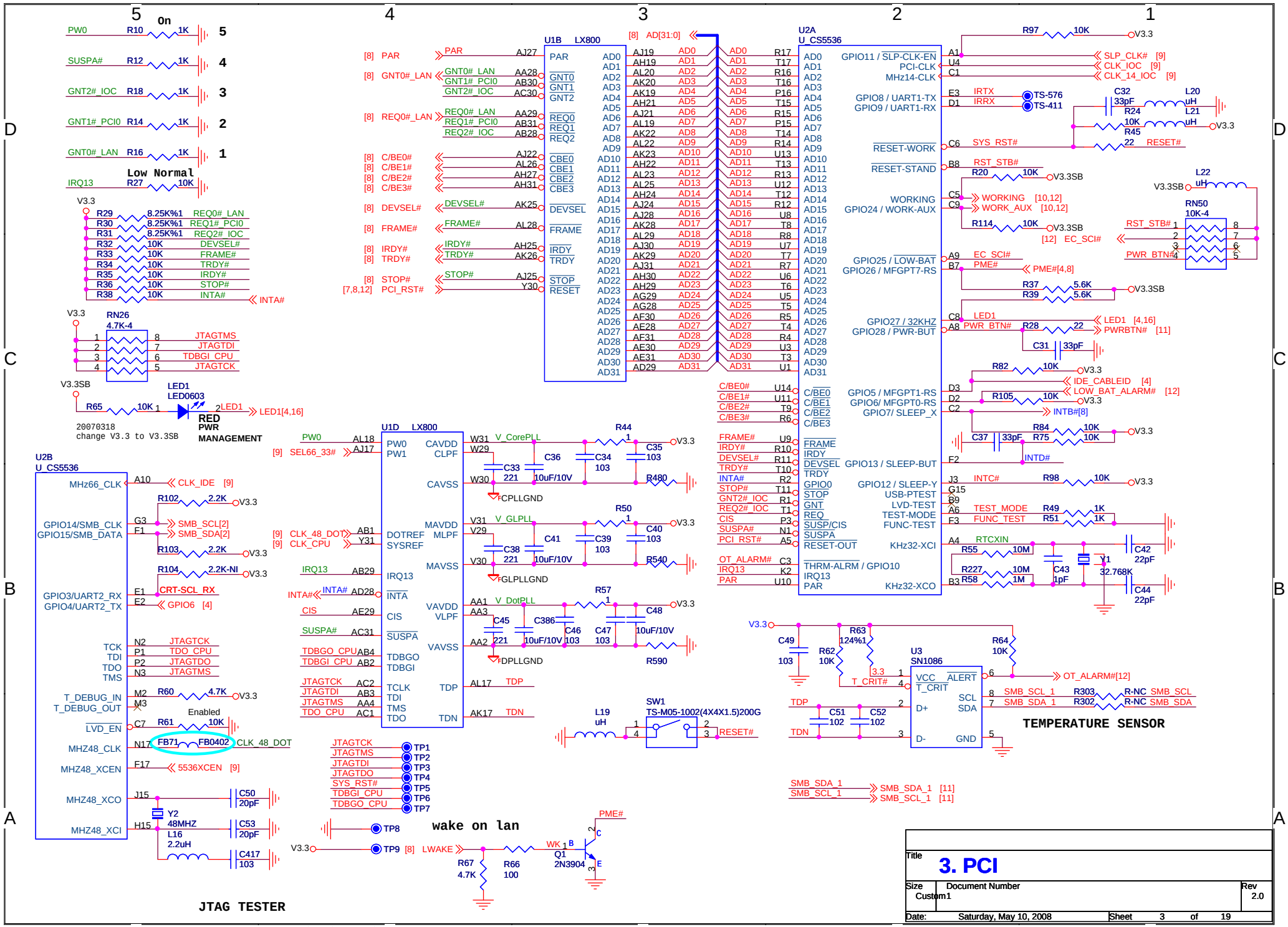
2007.11.30
page16 : 增加R123,
TC14 ;

01.Revisions V2.0

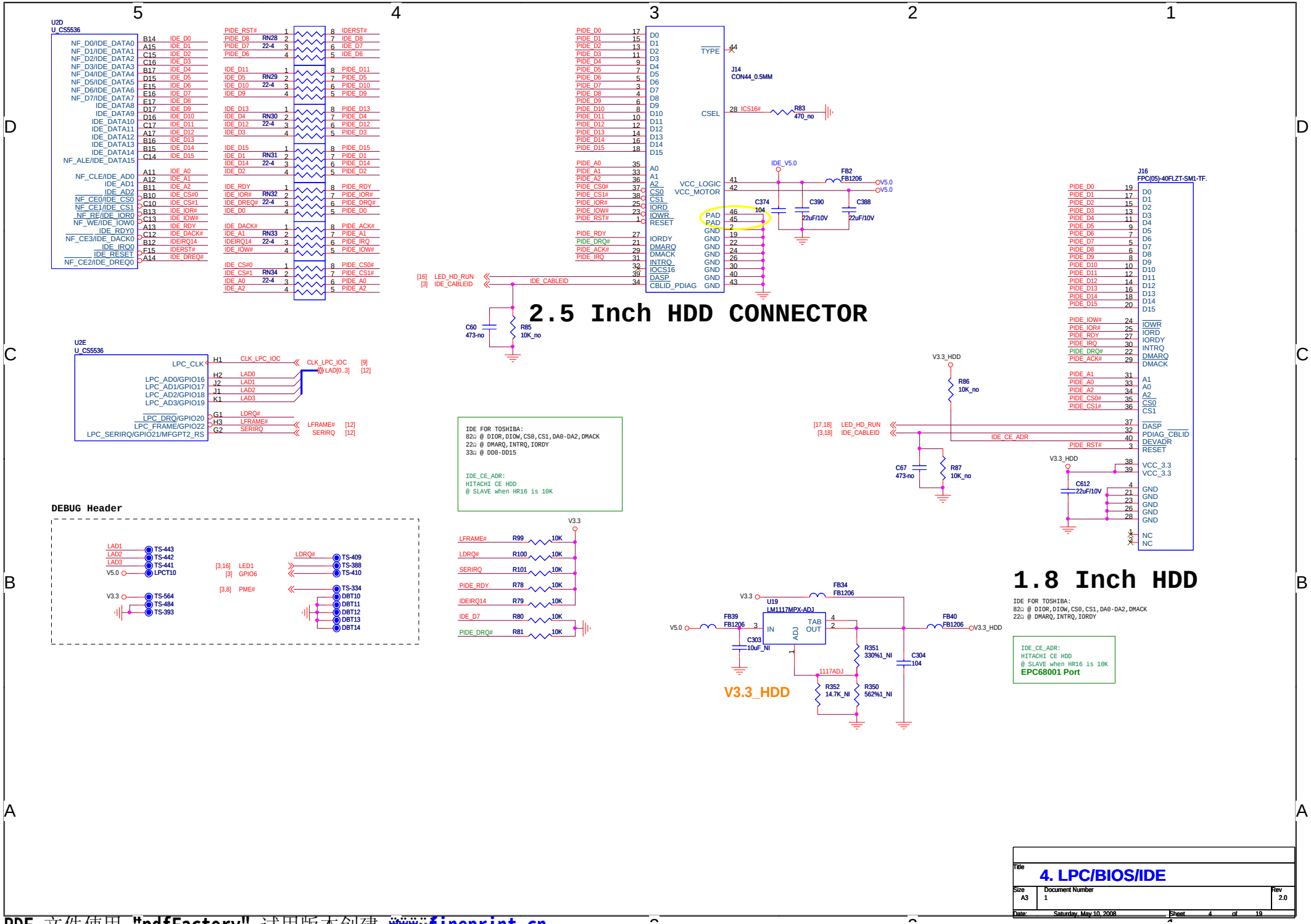
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



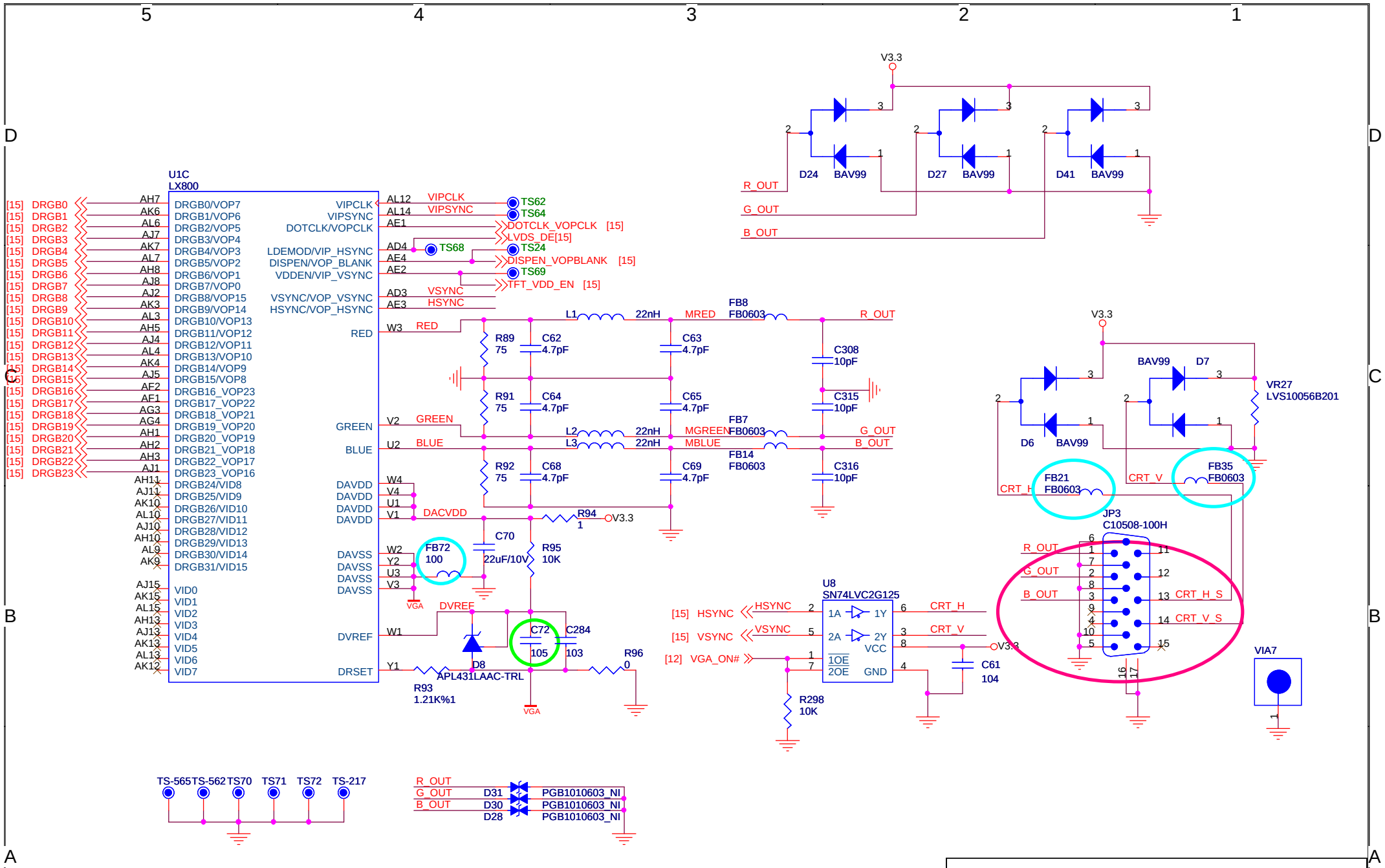
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



Title **5. LCD/VGA**

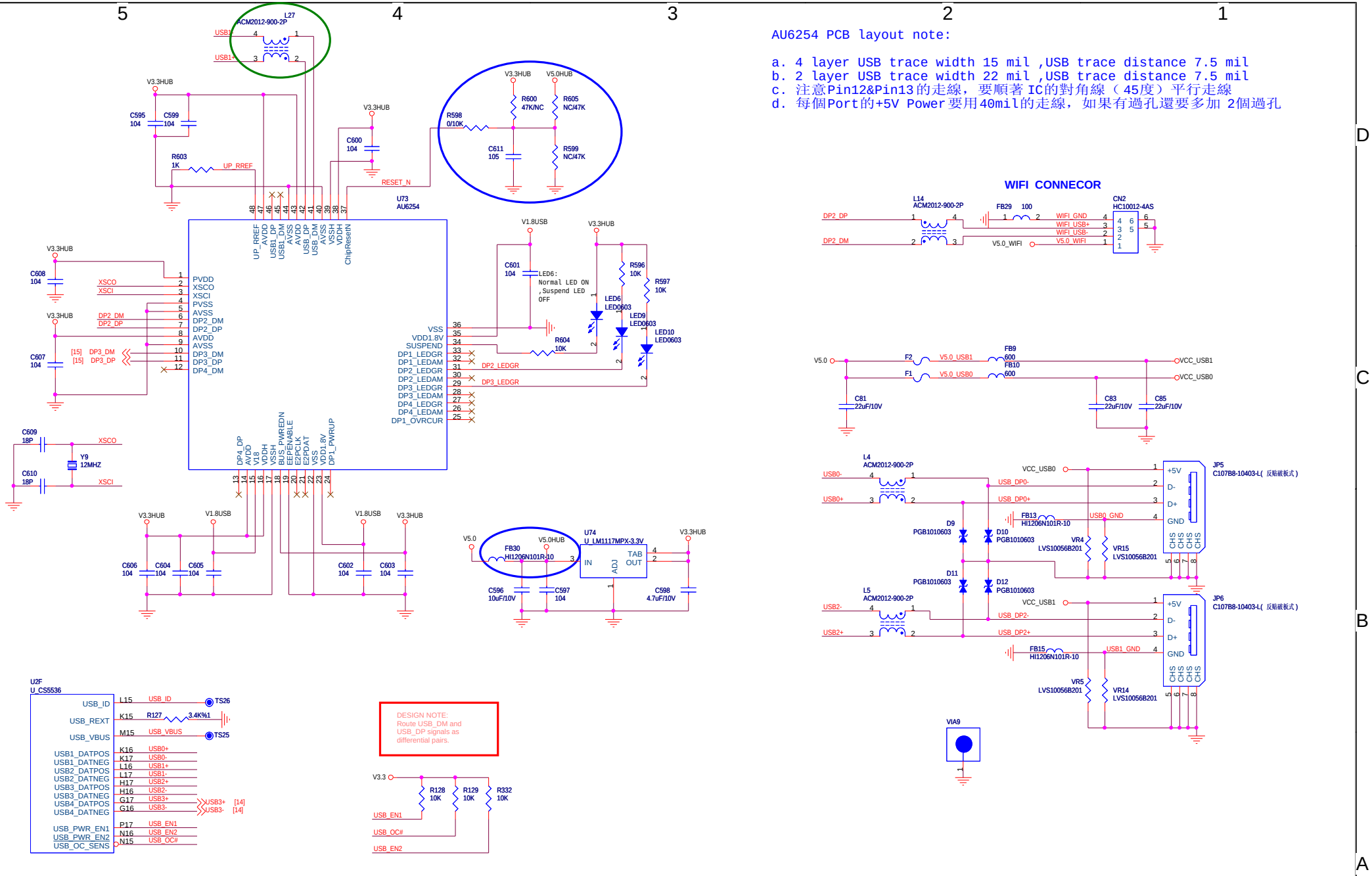
Size	Document Number	Rev
A4	1	2.0

Date: Tuesday, May 27, 2008 Sheet 5 of 19

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

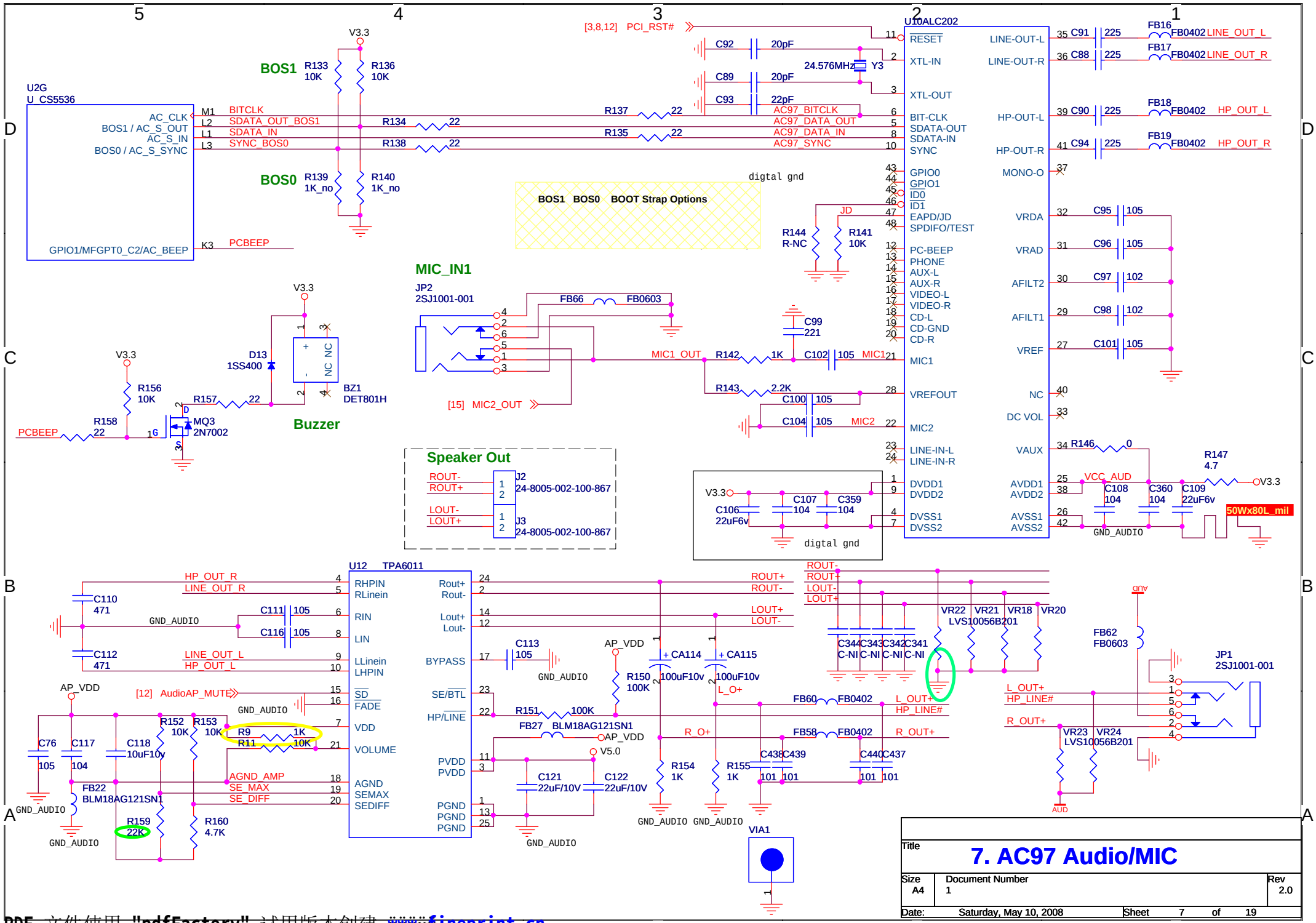
AU6254 PCB layout note:

a. 4 layer USB trace width 15 mil ,USB trace distance 7.5 mil
b. 2 layer USB trace width 22 mil ,USB trace distance 7.5 mil
c. 注意Pin12&Pin13的走線，要順著IC的對角線（45度）平行走線
d. 每個Port的+5V Power要用40mil的走線，如果有過孔還要多加 2個過孔

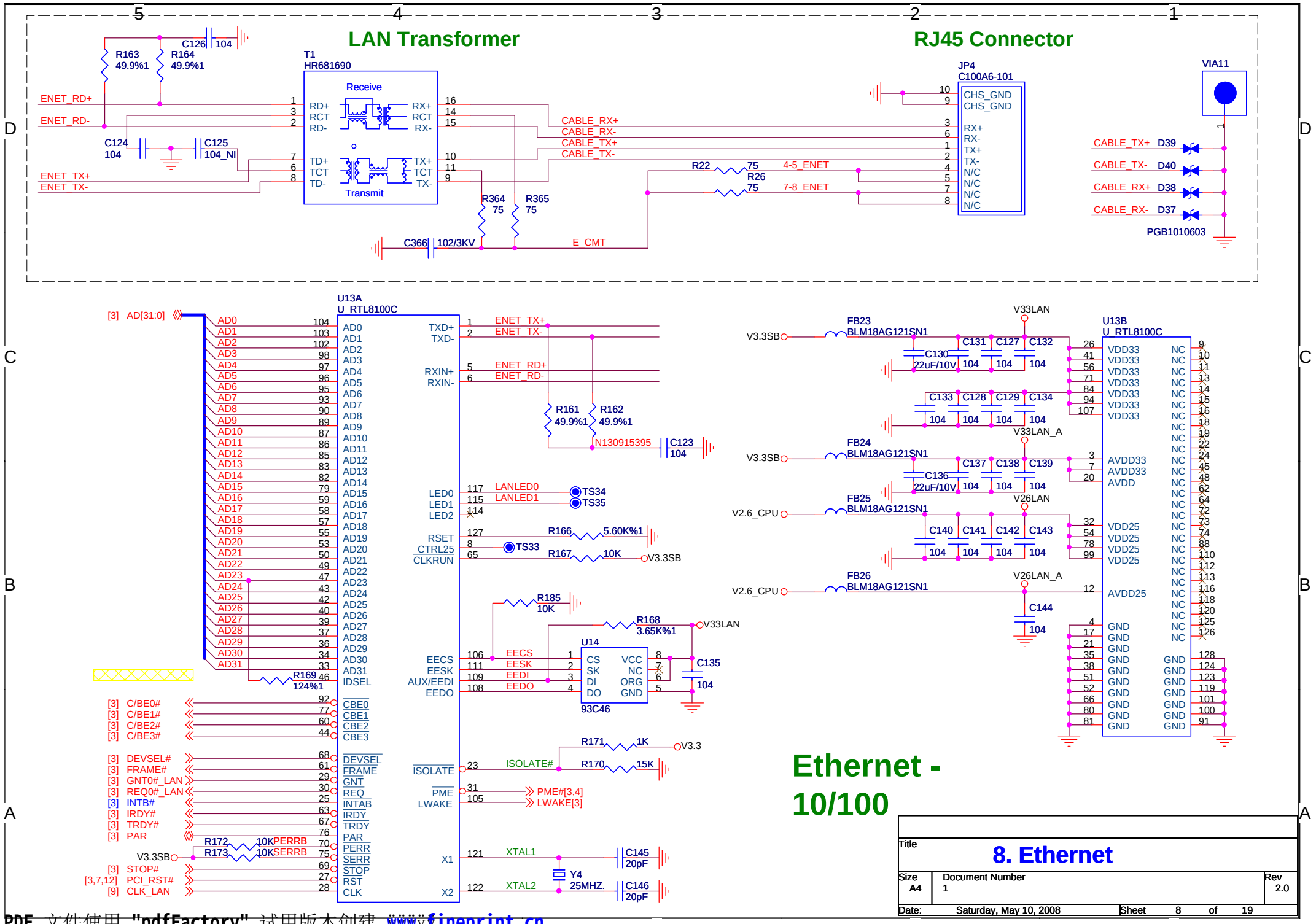


Title	6.USB-HUB	
Size A3	Document Number <Doc>	Rev <RevCode>
Date: Saturday, May 10, 2008	Sheet 6 of 19	

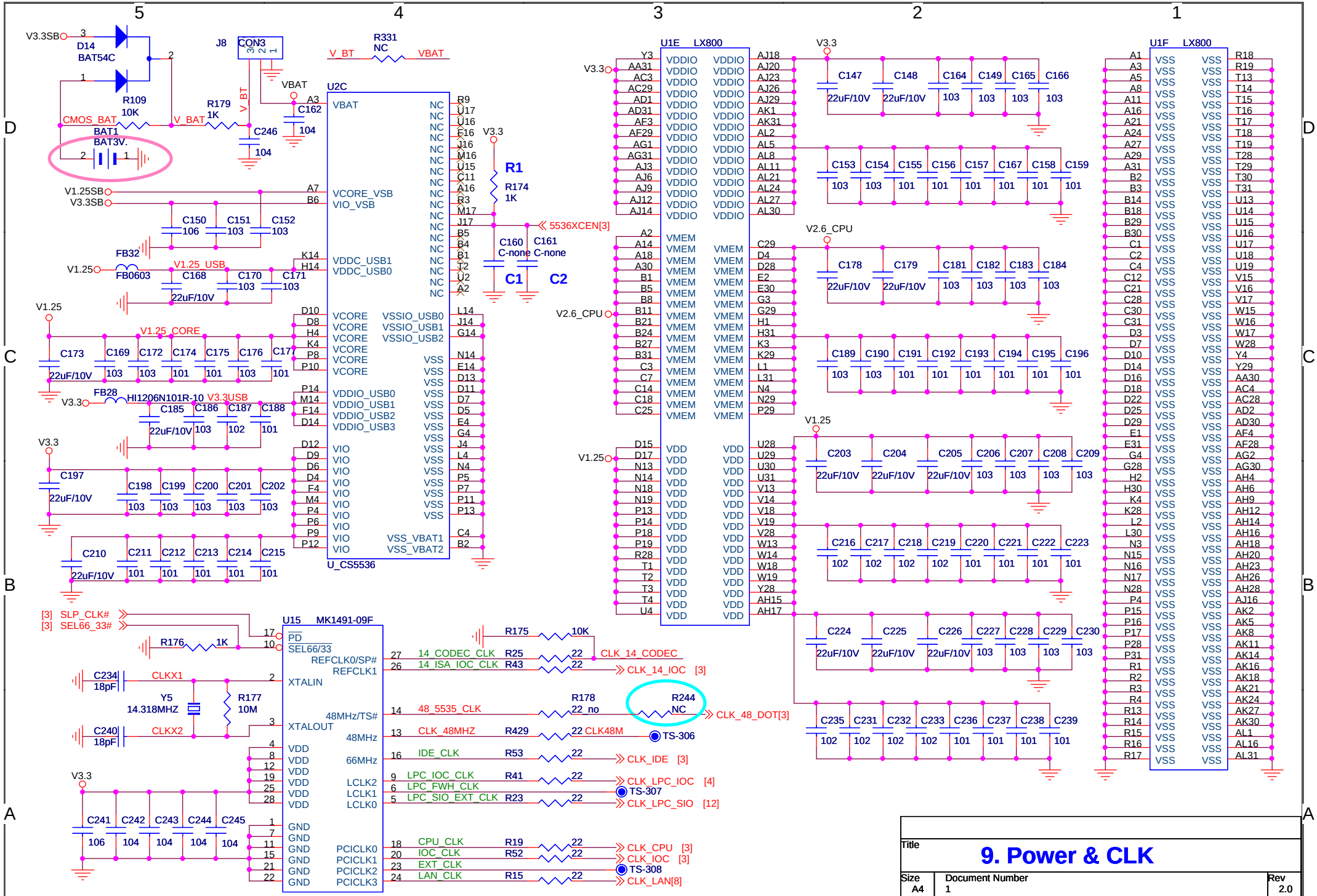
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



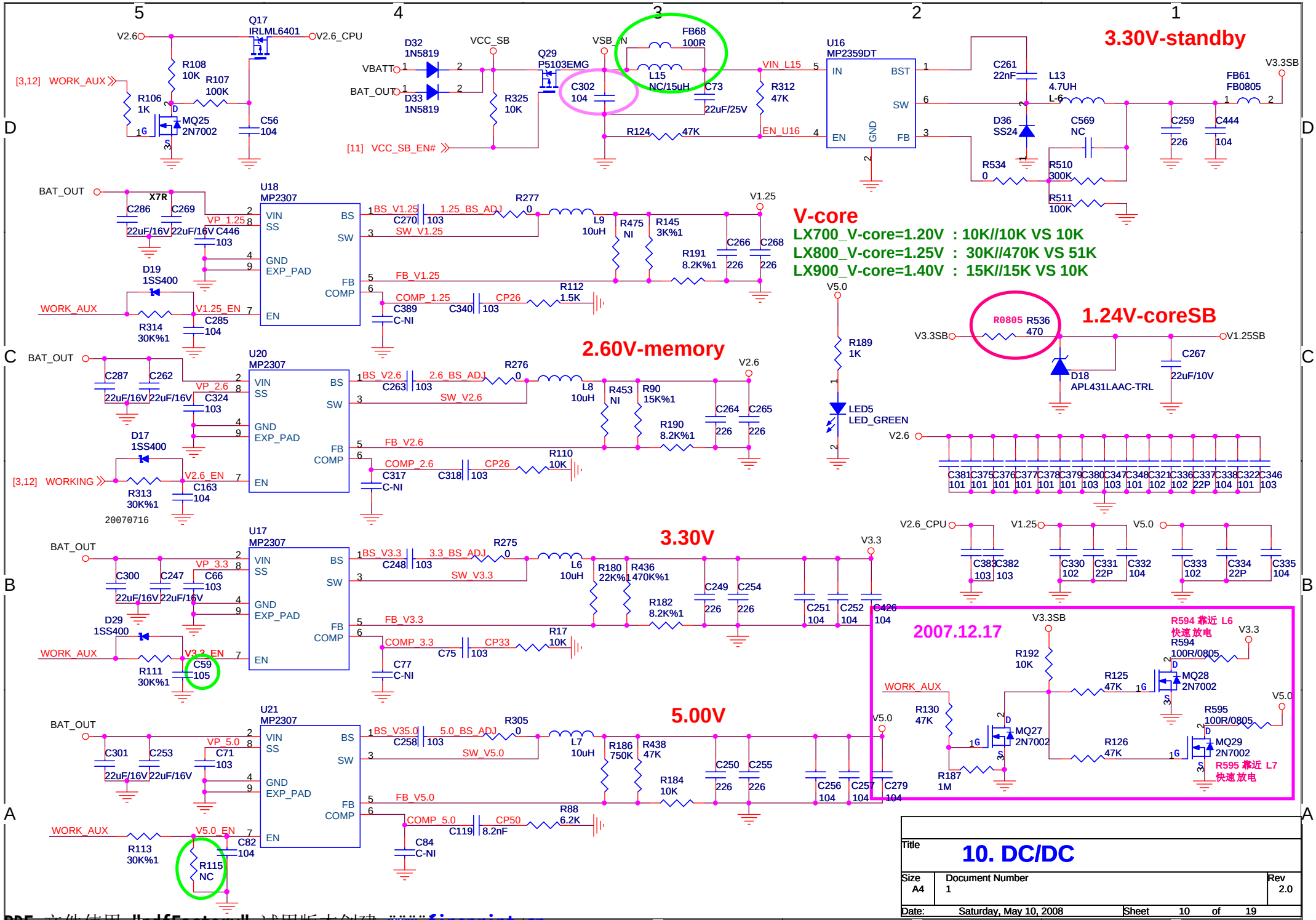
Title

9. Power & CLK

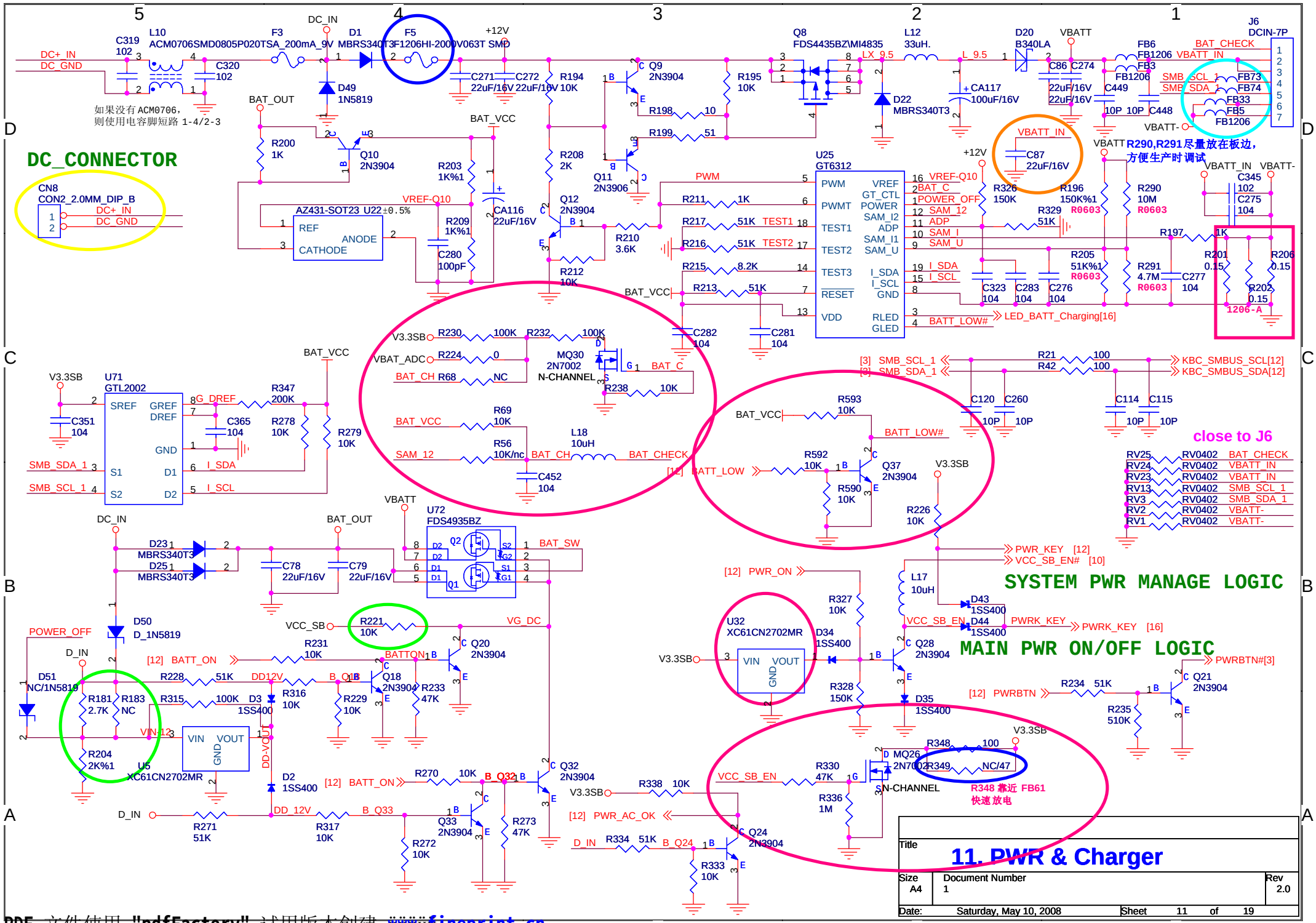
Size	Document Number	Rev
A4	1	2.0

Date: Saturday, May 10, 2008 Sheet 9 of 19

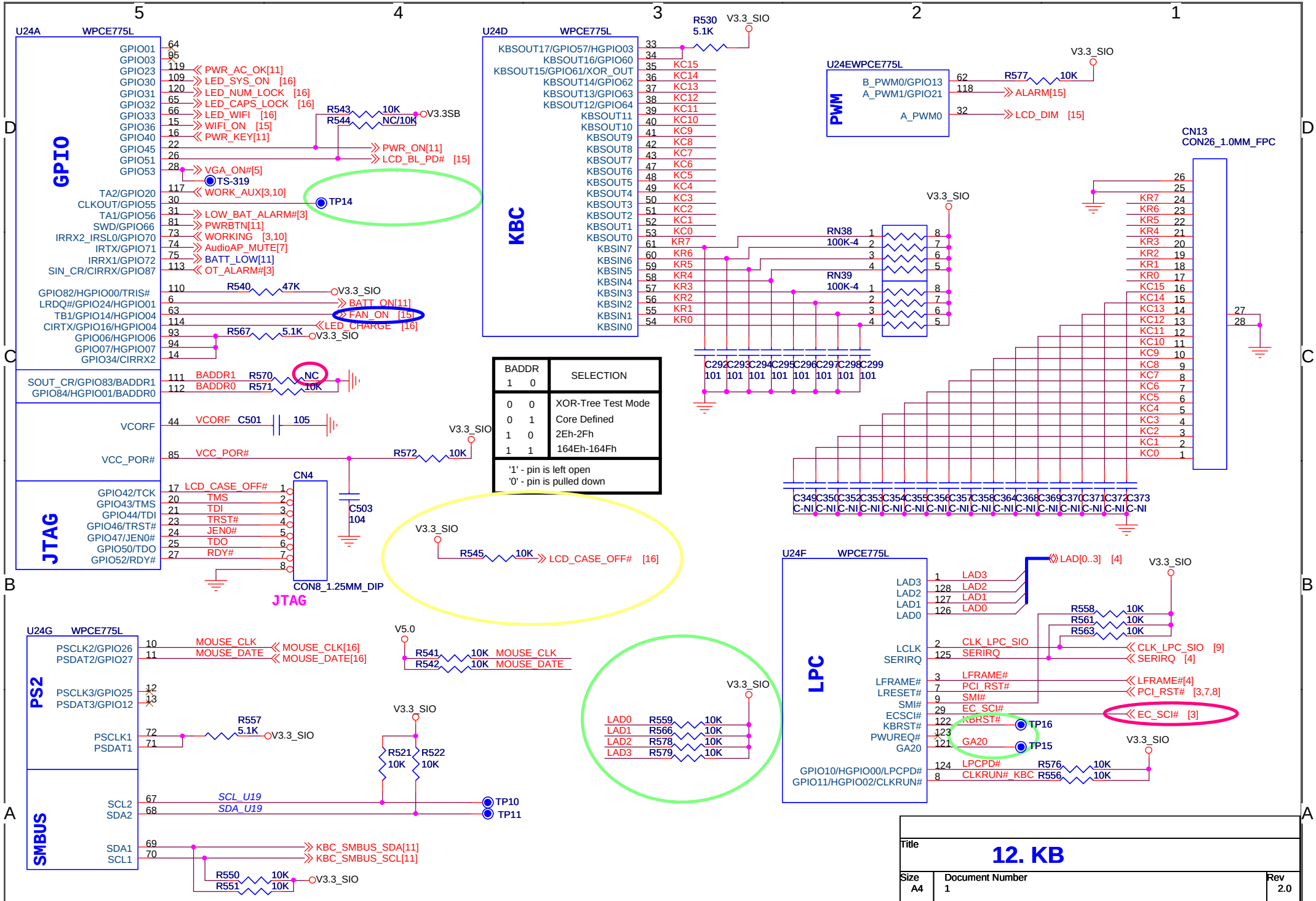
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



BADDR 1	BADDR 0	SELECTION
0	0	XOR-Tree Test Mode
0	1	Core Defined
1	0	2Eh-2Fh
1	1	164Eh-164Fh

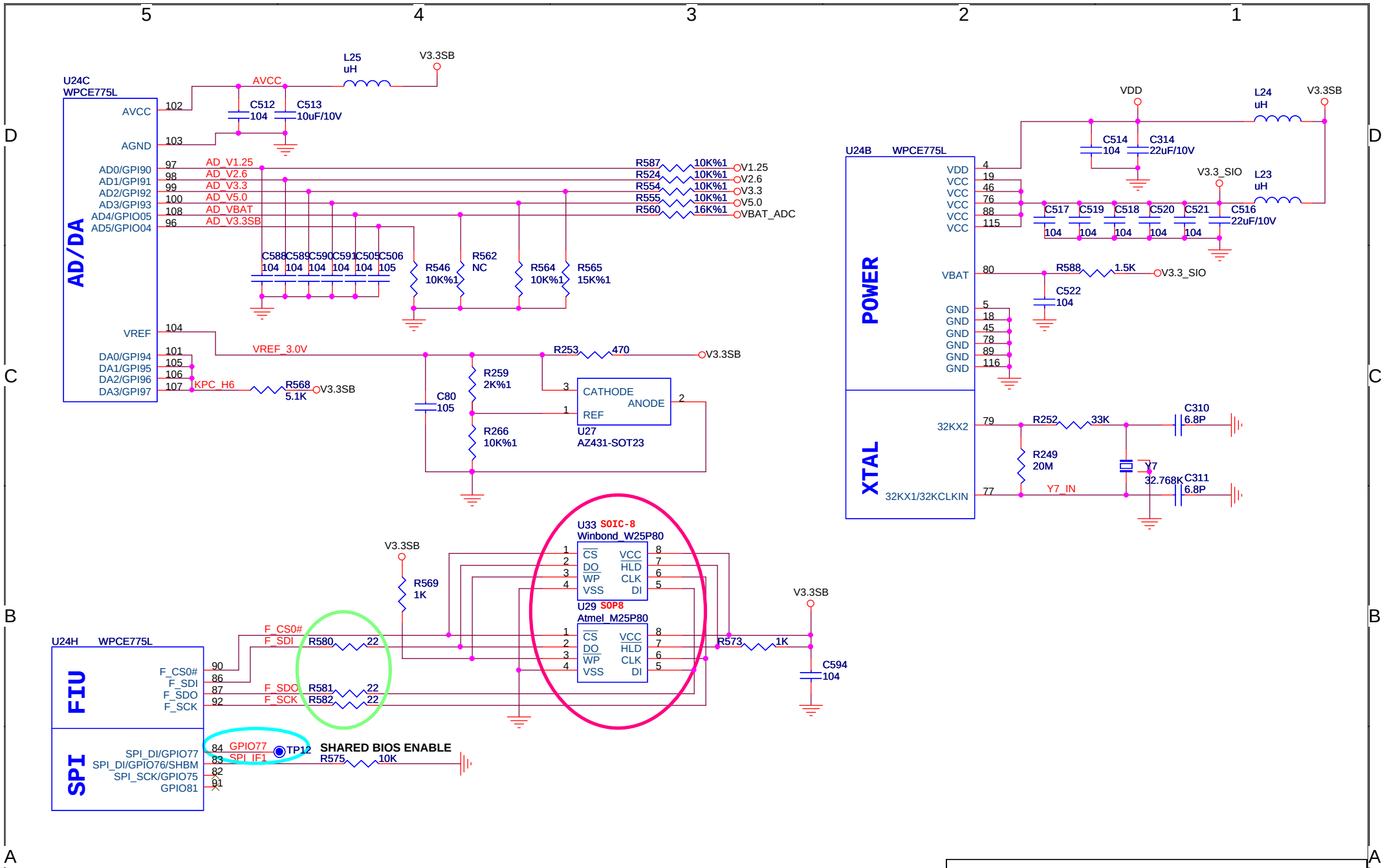
'1' - pin is left open
'0' - pin is pulled down

Title **12. KB**

Size	Document Number	Rev
A4	1	2.0

Date: Saturday, May 10, 2008 Sheet 12 of 19

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



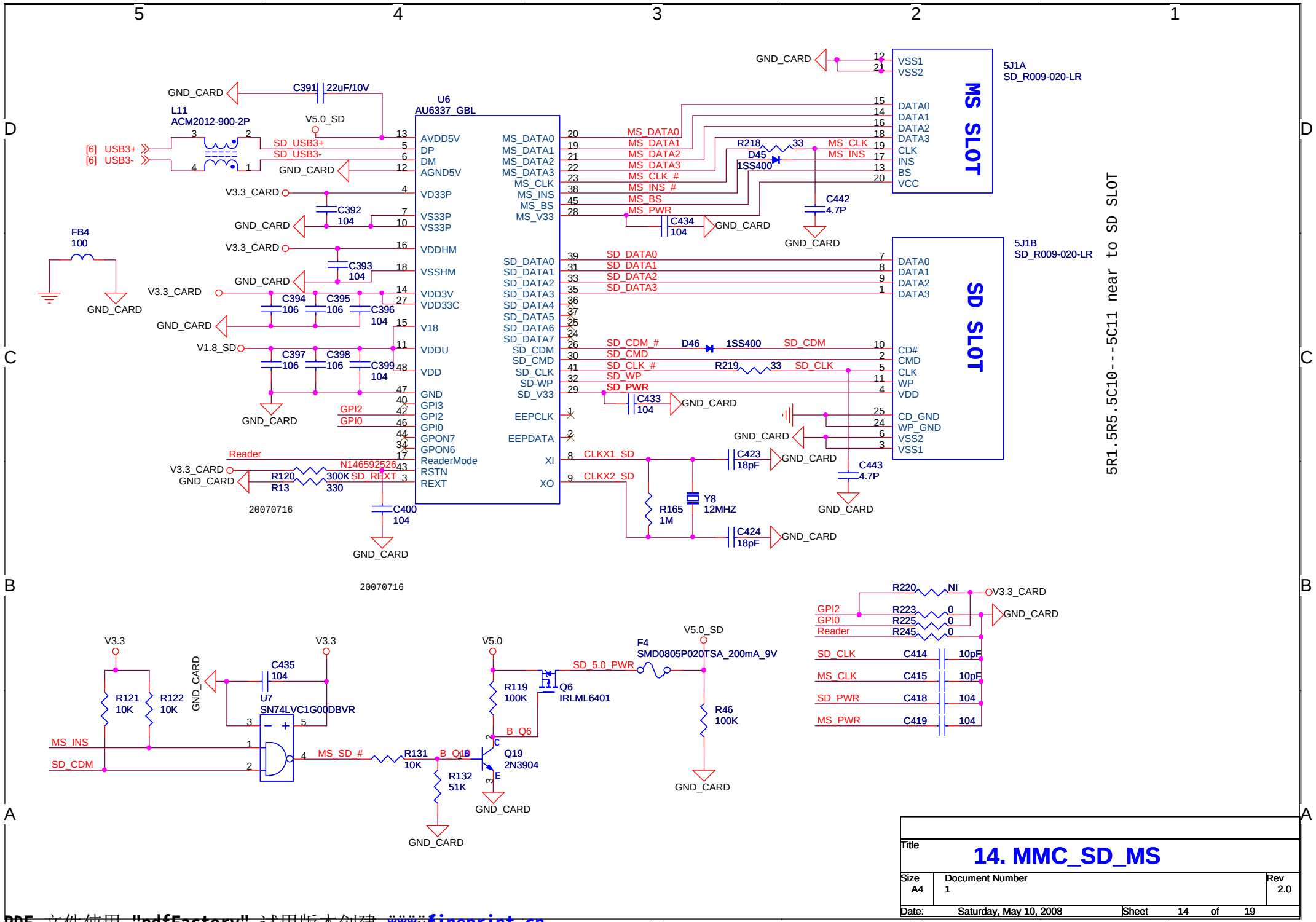
Title

13. AD/DA/SPI/POWER

Size	Document Number	Rev
A4	1	2.0

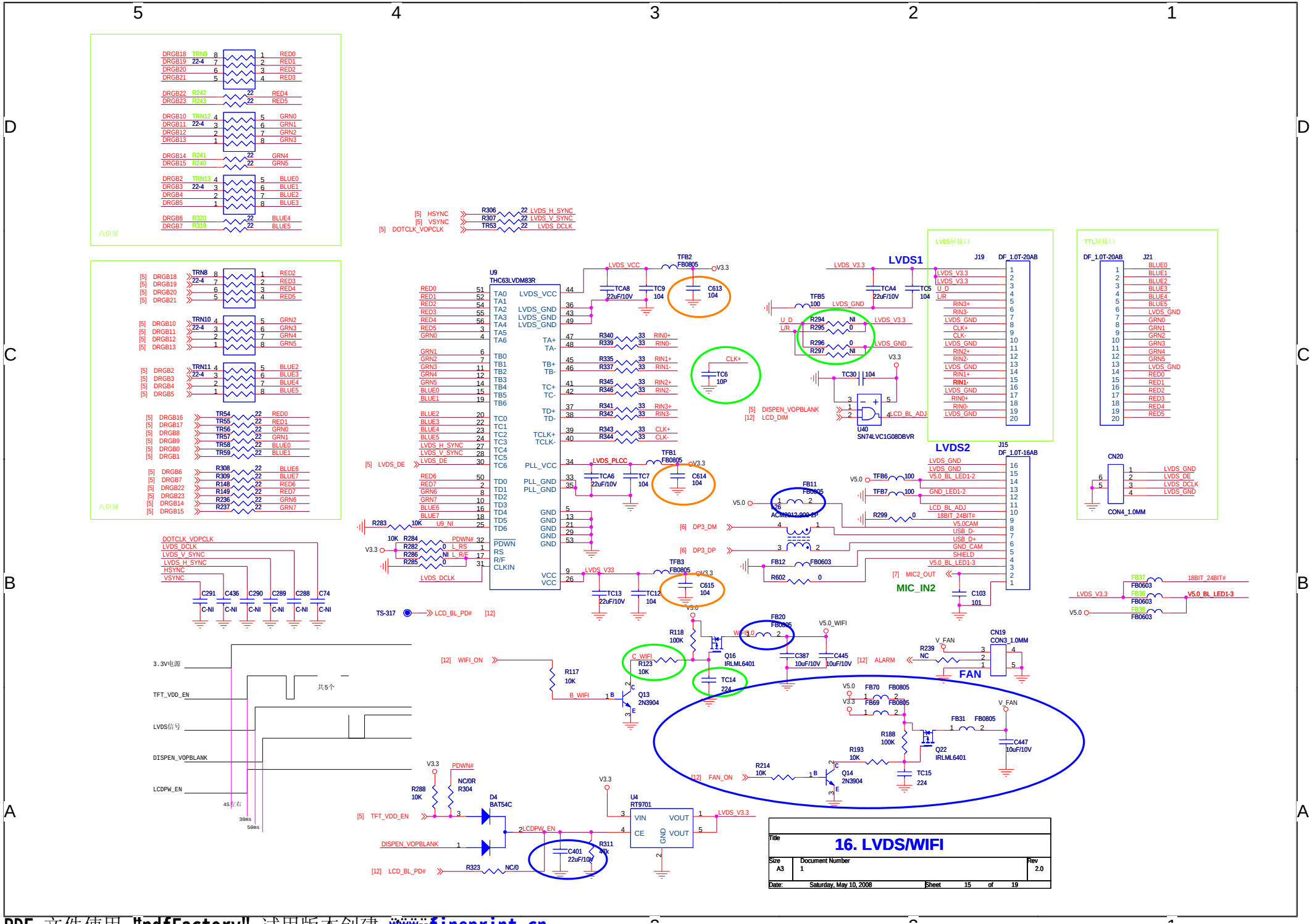
Date: Saturday, May 10, 2008 Sheet 13 of 19

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

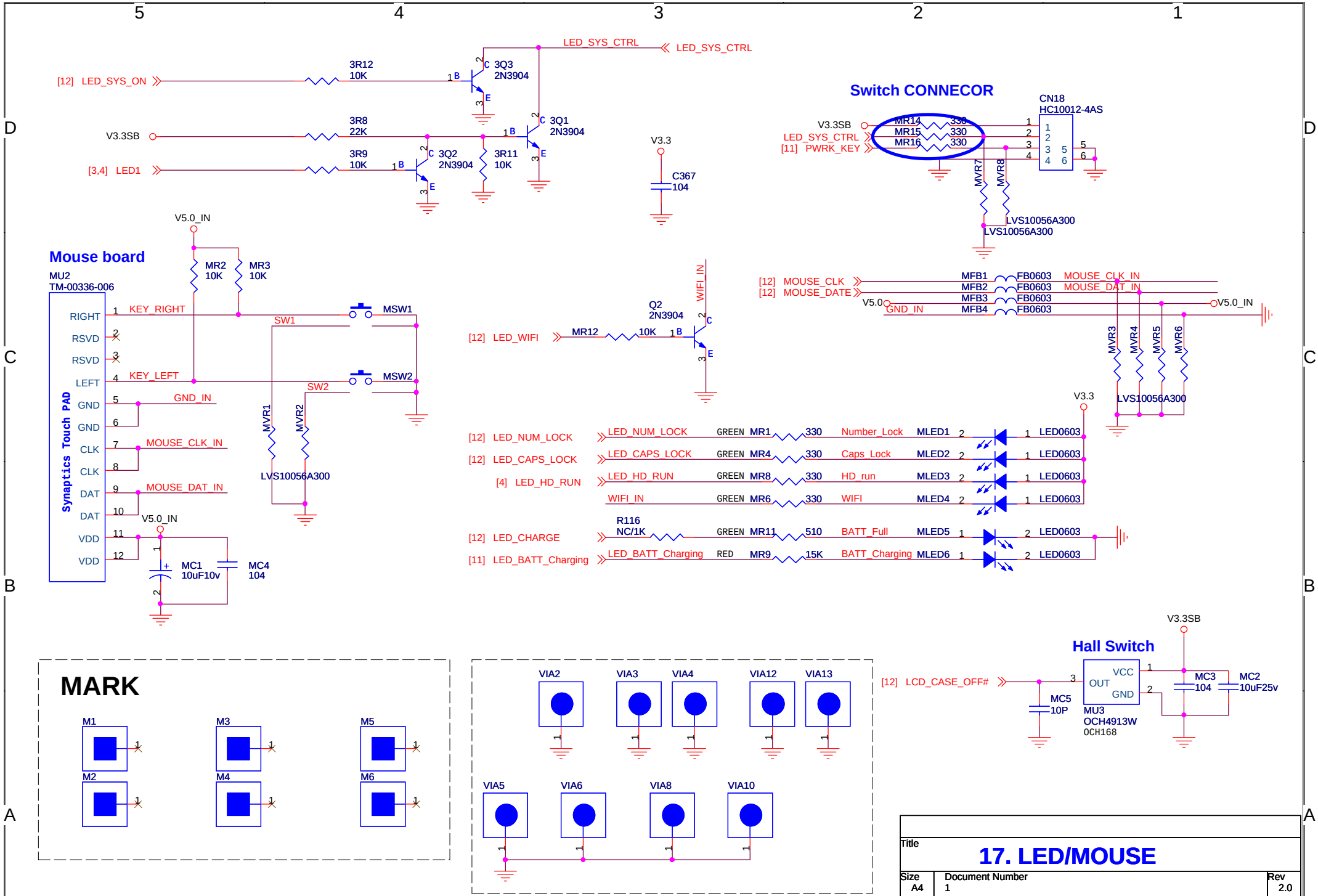


Title	14. MMC_SD_MS	
Size A4	Document Number 1	Rev 2.0
Date: Saturday, May 10, 2008	Sheet 14 of 19	

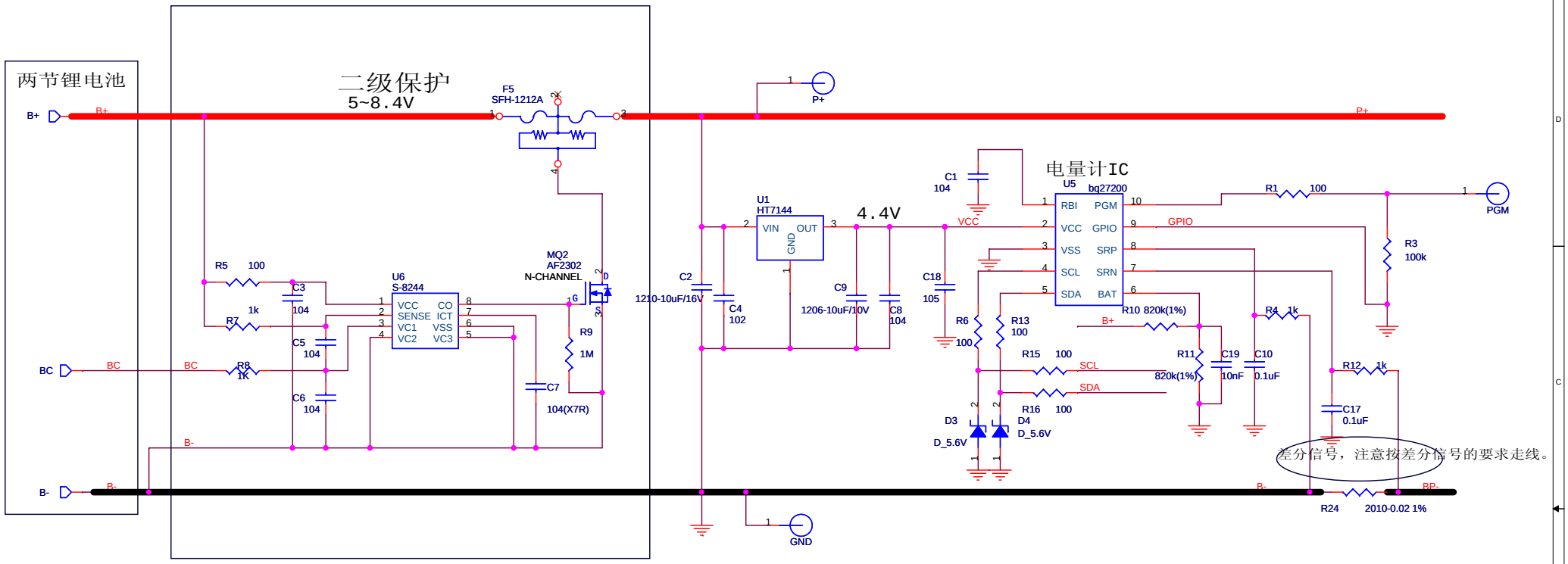
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

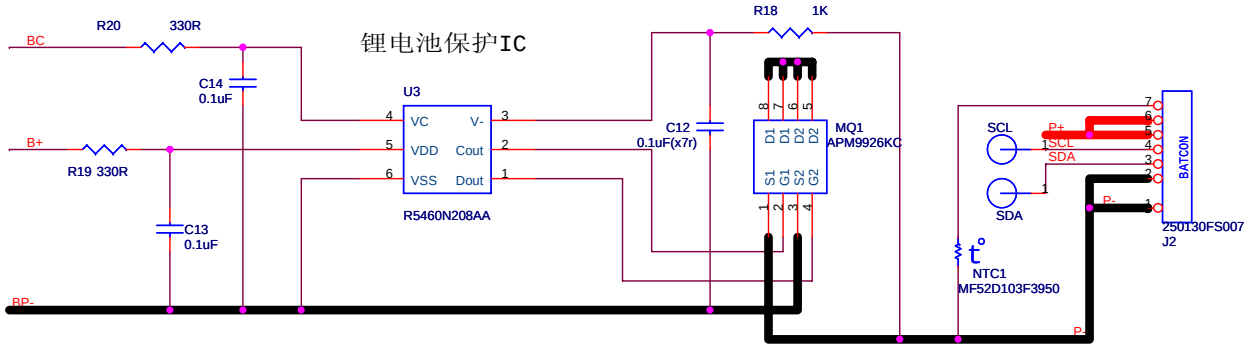


PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn



PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn





布板要求：

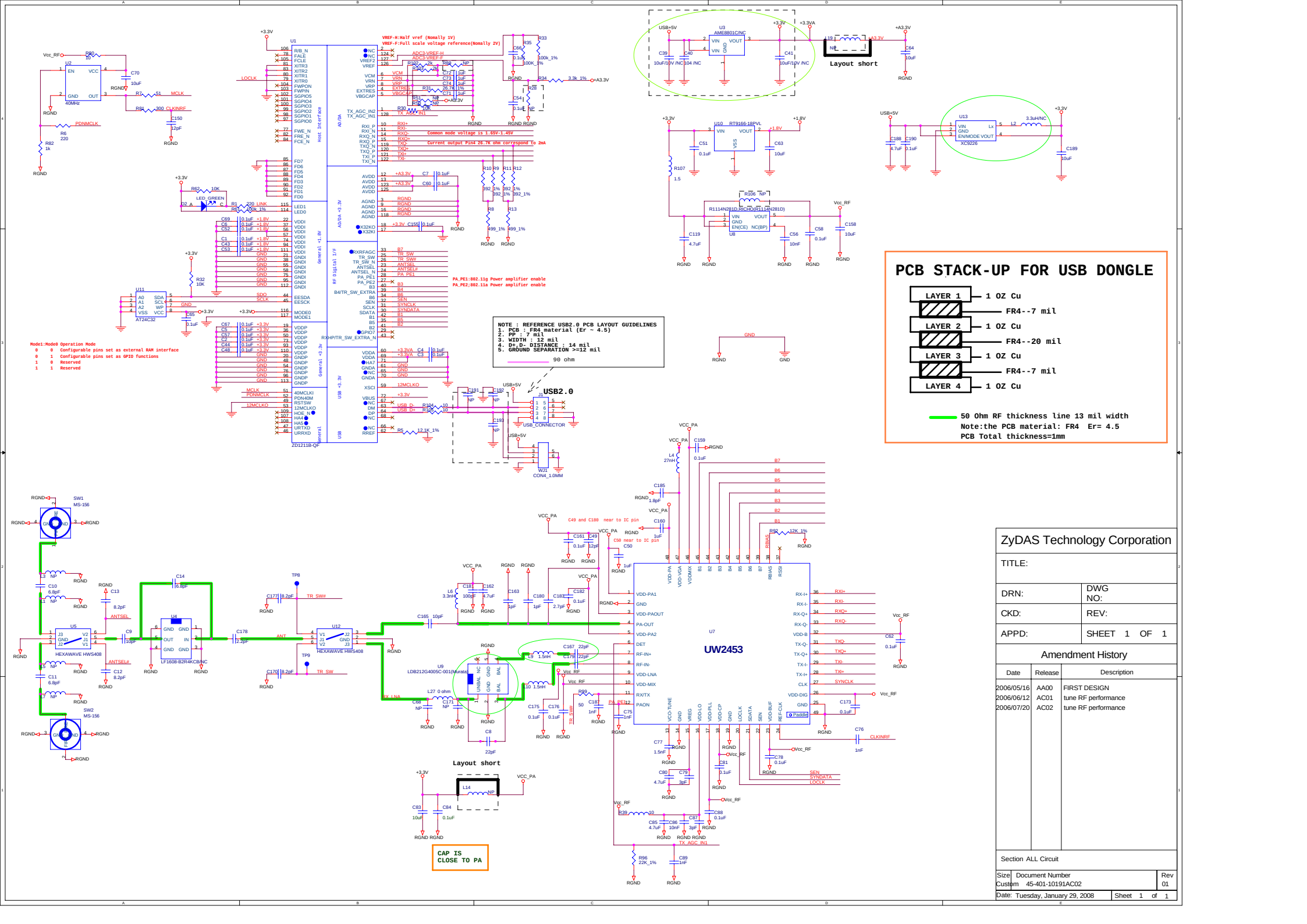
1.五个测试点 P+ B- PGM SCL SDA 都放在同一层，

2.加粗的线为大电流走线（1.6A）

3.差分信号走线要注意.

4.拼版按8拼1

Title	<Title>	
Size B	Document Number <Doc>	Rev <RevCode>
Date: Monday, April 21, 2008	Sheet 1 of 1	


PCB STACK-UP FOR USB DONGLE
LAYER 1
1 OZ Cu
FR4--7 mil
LAYER 2
1 OZ Cu
FR4--20 mil
LAYER 3
1 OZ Cu
FR4--7 mil
LAYER 4
1 OZ Cu
50 Ohm RF thickness line 13 mil width
Note:the PCB material: FR4 Er= 4.5
PCB Total thickness=1mm
NOTE : REFERENCE USB2.0 PCB LAYOUT GUIDELINES
1. PCB : FR4 material (Er ~ 4.5)
2. PP : 7 mil
3. WIDTH : 12 mil
4. D+,D- DISTANCE : 14 mil
5. GROUND SEPARATION >=12 mil
90 ohm
USB2.0
Layout short
UW2453
ZyDAS Technology Corporation
TITLE:
DRN:
DWG NO:
CKD:
REV:
APPD:
SHEET 1 OF 1
Amendment History
Date | Release | Description
2006/05/16 | AA00 | FIRST DESIGN
2006/06/12 | AC01 | tune RF performance
2006/07/20 | AC02 | tune RF performance
Section ALL Circuit
Size Document Number Rev
Custom 45-401-10191AC02 01
Date: Tuesday, January 29, 2008 Sheet 1 of 1